

Unit 230, 2/F, Building 12W, No. 12 Science Park West Avenue, Phase 3, Hong Kong Science Park, Pak Shek Kok, N.T., Hong Kong

## 专利意念简介

A. 发明的名称(中文及英文)

В.	采用的科技(请在其中一个方格内加」 术及/或原理)	上'√'号,并解释涉及的技
	<ul><li>□ 电子/电力</li><li>□ 金属/塑料/材料学</li><li>□ 纺织/制衣</li><li>□ 环境</li></ul>	<ul><li>□ 信息科技</li><li>□ 生物科技</li><li>□ 其他(请注明)</li><li>□ — —</li></ul>
C.	拟在哪些国家/地区申请专利(请按( 1	
D.	<b>发明介绍</b> 1. 发明背景	

2. 发明简介 - 该发明有何用途?如何操作?(可用主要技术 用语介绍有关发明)(请在 250 字內作出简介)

## 专利意念详情

## A. 发明介绍

1. 简介如何落实发明意念以达到既定目标(包括制作/建造所涉及的原理和法)

2. 图则简介(包括草图、图表、流情图、表或照片)

1.	请	列	出	和	介	绍	任	何	就	你	所	知	的	同	类	或	拟	取	得	相	同	成	果	的	其	他
	产	品	/	方	法	0	请	指	出	旧	有	产	品	/	方	法	的	缺	点	和	现	时	发	明	的	优
	点	0																								

2. 请列明和介绍任何就你所知与现时发明相近的专利或曾发表/公开的发明(如适用)

专利编号/名称:		
发表/公开日期:		
是否存有该资料的副本	. 足	否

3. 请说明现时发明在技术上/或在功能上与上述的先有技术有何不同。